

文一三佳科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 6 月 5 日（星期一）上午 11:00—12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了 2022 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2023 年 5 月 27 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《文一科技关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告》（临 2023-025）。2023 年 6 月 5 日上午，公司董事长杨林先生，董事总经理丁宁先生，副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生，独立董事储昭碧先生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2022 年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的问题及预征集的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下：

1、投资者提问：“请问公司与长鑫存储是否有合作或者业务往来？公司在半导体领域自主研发的国产替代设备有哪些？公司研发的扇外型晶圆级液体封装压机设备进展如何？是否有 TSV 技术储备？公司董事会未来新的战略规划是？”

回复：根据所问问题，依次回复如下：

(1) 截止目前，我公司与长鑫存储未有直接的合作或者业务往来。

(2) 公司在半导体领域自主研发的国产替代设备主要有：半导体自动封装系统、半导体冲切成型系统等系列产品。

(3) 公司扇外型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，即研发的第一台手动样机已交付客户试用。距离批量生产及后续研发还有很多难关需要解决且存在不确定性，主要受限于技术因素和市场因素不确定的影响。

(4) TSV 是硅通孔技术，跟我公司产品没有关系。

(5) 请参考公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《文一科技 2022 年年度报告》中“关于公司未来发展的讨论与分析”中相关内容。

2、投资者提问：“询问一下之前日方的设备技术是否全部在公司保留？”

回复：收购事项不影响三佳山田之前已掌握的设备核心技术。

3、投资者提问：“三佳山田之前已掌握的设备核心技术可以详细阐述一下吗？”

回复：三佳山田一直是独立运营的法人，其之前掌握的关于电子塑封模具、冲切成型系统等产品的专利技术一直属于三佳山田，不会受其股权变化的影响。

4、投资者提问：“贵公司对于市值有何看法？”

回复：股价的涨跌是受市场多种因素综合影响的结果。公司股东、经营层及上下全员心系公司，将一如既往的致力于聚焦主业，争取发展好公司，以回报广大投资者。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月五日